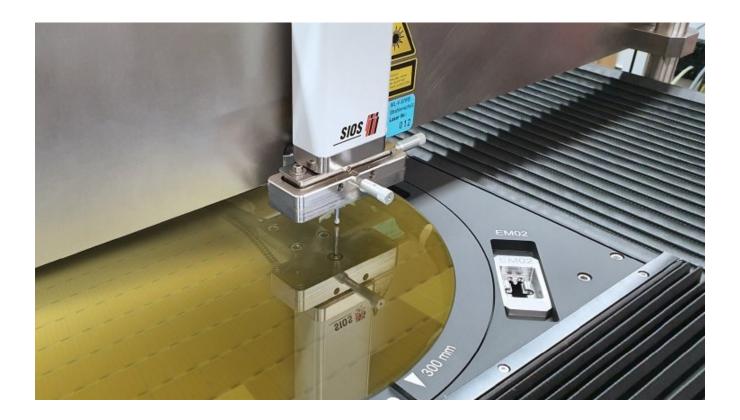
Hochpräzise Dickenmessung mit taktilen Tastern



Der allgemein anhaltende Trend zu Präzision, Miniaturisierung und Automatisierung in Industrie und Forschung stellt hohe Anforderungen an Präzisionsmesssysteme, welche die geometrischen Abmessungen von Objekten erfassen.

Ein Spezialfall ist dabei die hochgenaue eindimensionale Messung der Dicke von Präzisionsobjekten. Eigens konzipierte Messplätze auf der Grundlage interferometrischer taktiler Messtaster sind in der Lage, die Dicke mit Messunsicherheiten im Bereich von 10 nm zu erfassen. Beispiele hierfür sind Endmaßkomparatoren oder Messplätze für die Messung der Dicke von Präzisionsoptiken oder Siliziumwafern.

In unserem ca. **45-minütigen Webinar** erhalten Sie einen Einblick in die Problematik der hochpräzisen Dickenmessung von ausgedehnten Objekten mit taktilen Messköpfen.

Beginnend mit der Beschreibung typischer Einflüsse und Beiträge zur Messunsicherheit, vergleichen wir verschiedene Geräteprinzipien für diese taktile Längenmessung.

Wir werden Ihnen die interferometrischen taktilen Messtaster LM 20 und LM 50 von SIOS sowie deren Vorteile gegenüber anderen hochgenauen Messtastern vorstellen.

Darüber hinaus werden Anwendungsbeispiele für hochpräzise Dickenmessungen wie der SIOS-Endmaßkomparator, der Linsen- oder Waferdickenmessplatz gezeigt.

Schließlich stellen wir Beispiele vor, wie bestehende (taktile) Längen- und Dickenmessplätze mit Interferometern aufgerüstet werden können, um ihre Auflösung und Präzision zu erhöhen.

Beginn:

Dienstag, 8. März 2022, 08:30 Uhr

Ende:

Dienstag, 8. März 2022, 09:30 Uhr

Veranstaltungsort:

Online

Website & Anmeldung:

https://sios.de/webinar-hochpraezise-dickenmessung/